

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2024-084

山石网科通信技术股份有限公司

关于自愿披露公司 ASIC 安全专用芯片研发进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）研发的 ASIC 安全专用芯片（以下简称“ASIC 芯片”）近日完成了第一次试产流片。试产芯片于 2024 年 9 月底按期回片，并在公司内部成功完成验证测试，所有指标均达到设计要求。

● 风险提示：

本次测试完成后，ASIC 芯片还需进入量产流片环节。从 ASIC 芯片研发完成到产品量产尚需一定的周期，该过程中存在相关产品应用时间不确定、下游市场需求变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将相关研发进展公告如下：

一、ASIC 安全专用芯片的相关情况

1、研发情况和最新进展

为提高公司国产化安全硬件产品的性能和稳定性以及产品性价比，公司于 2021 年启动了芯片研发计划。第一阶段，公司在 FPGA 上实现了芯片构架和逻辑的验证，并于 2022 年 5 月发布了首款搭载 FPGA 的产品；2022 年 11 月，公司启动了芯片研发计划的第二阶段，即自研 ASIC 芯片设计阶段。

2024 年 3 月，公司将 ASIC 芯片交付生产厂家进行第一次试产流片，并于 9

月底按期回片。目前公司已将试产芯片在多款硬件平台上完成了适配，并进行了冒烟测试、信号测试、功能测试、性能测试，测试结果均达到设计要求。综上，经公司内部综合评估，公司已完成 ASIC 芯片试产阶段的研发并取得内部测试的成功。

2、后续研发安排

现阶段，公司正持续进行试产芯片的完整功能和压力测试，待完成功能和压力测试后，ASIC 芯片将进入到量产流片阶段；量产芯片回片并测试通过后进入产品化应用阶段。目前，公司初步预计将在 2025 年陆续推出搭载 ASIC 芯片的安全产品。

二、对公司的影响

公司对上述安全芯片技术具备完全自主知识产权，ASIC 芯片试产阶段的内部测试成功，验证了公司技术路线的可行性，有利于继续推进 ASIC 芯片研发下一阶段工作。

本次 ASIC 芯片的研发，自 FPGA 阶段起，即受到来自金融、互联网、运营商、教育、能源等行业客户的关注和支持。本次验证成功将加快 ASIC 芯片产品化的整体进展，但因目前尚未进入基于 ASIC 芯片的产品化阶段，预计本次进展不会对公司 2024 年业绩产生重大影响。后续，公司将持续推进安全芯片研发工作，进一步完善公司产品矩阵，巩固和提升公司的综合竞争力。

三、风险提示

本次进展为公司 ASIC 芯片试产流片的内部测试取得良好结果，尚未进入基于 ASIC 芯片的产品化阶段。从 ASIC 芯片研发完成到产品量产尚需一定的周期，该过程中存在相关产品应用时间不确定、下游市场需求变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日